

Описание товара

- 100% новый и высокое качество!
- Флюс канифоли используется для облегчения пайки.
- Он очищает и предотвращает окисление металла, что позволяет припояю создавать прочные, долговечные механические и электрические связи.
- Он также действует как смачивающий агент, увеличивая поток припоя и эффективность процесса пайки.
- Идеально подходит для мобильных телефонов, компьютерных карт и другой сложной электронной сварки на уровне кристалла.

Характеристики

Продукт: BST-706

Температура плавления: 138 °C

Вес: 500 г

Состав: Sn99%, Cu0.7%, Ag0.3%

SOLDER PASTE

Lead-free medium temperature



500g

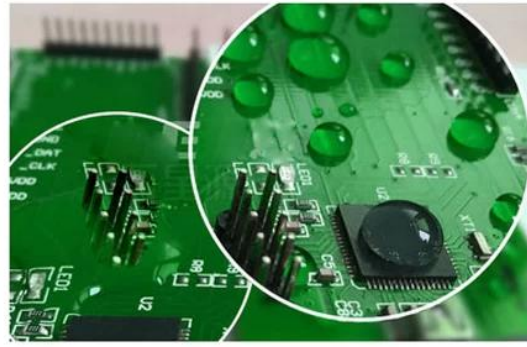
Low residue / Rapid welding / lead free / Solder spot bright

// Product Usage

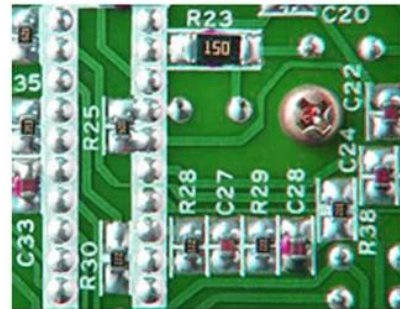
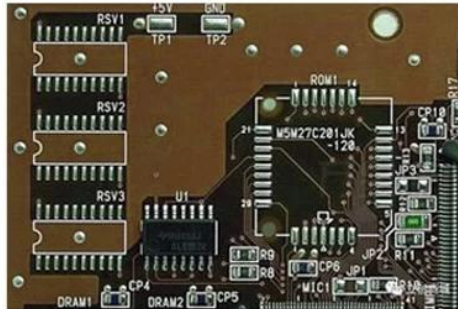


MODEL	BST-706
SHELF LIFE	6 months
INGREDIENT	Sn42/Bi58
WEIGHT	500g
MELTING POINT	138°C

Having a large insulation resistance does not corrode the PCB, and the requirements for no-cleaning can be achieved.



High impedance, full and bright solder, low residue

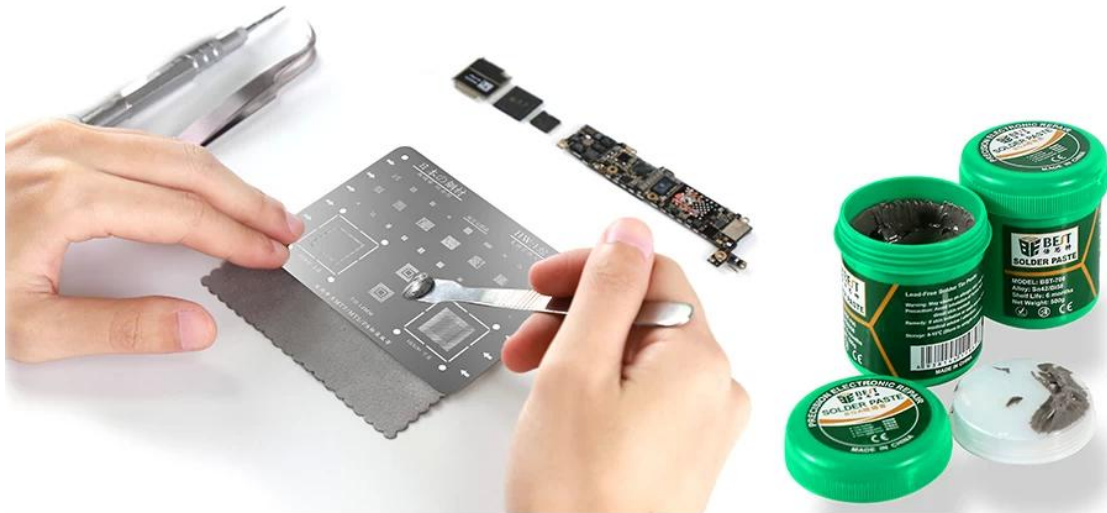


Welding requirements for a wide range of products



TESTING EFFECT

UNIFORM SOLDER JOINT
MEDIUM TEMPERATURE MELTING POINT



PRODUCT SIZE



63.0MM



52MM

75MM

